

Расписание

Часть 4. Высокочастотное и низкочастотное корпусное экранирование: теория и практика

День 1

Время	Тема	Длительность, ак. часов.
09.00 - 09.20	Регистрация. Приветственный кофе.	
09.20-10.50	1. Теория высокочастотного корпусного экранирования 1.1. Общие подходы к разработке электромагнитных экранов. 1.2. Импеданс поля помехи, потери в экране, 1.3. Изоляция помеховых токов с помощью экранирования и фильтрации.	2
10.50-11.20	Перерыв/Кофе-брейк	
11.20-12.50	1.4. Оценка прозрачности одиночных отверстий (сверху и снизу). 1.5. Оценка прозрачности массива отверстий, эффективность перфорированных экранов. 1.6. Эффективность предельных волноводов.	2
12.50-13.50	Обед	
13.50-15.20	2. Практика высокочастотного корпусного экранирования: 2.1. Зонирование корпуса. 2.2. Методы экранирования отверстий под индикаторы и органы управления. 2.3. Технологии снижения импеданса экрана.	2
15.20-15.50	Перерыв/Кофе-брейк	
15.50-17.20	2.4. Локальные экраны. 2.5. Методы борьбы с полостным резонансом. 2.6. Технологии изготовления экранирующих корпусов. 2.7. Примеры из практики.	2

Расписание

Часть 4. Высокочастотное и низкочастотное корпусное экранирование: теория и практика

День 2

Время	Тема	Длительность, ак. часов.
09.00 - 09.20	Регистрация. Приветственный кофе.	
09.20-10.50	3. Экранирование низкочастотного электрического и магнитного полей 3.1. Экранирование электрического поля проводниками и диэлектриками. 3.2. Частичное и полное экранирование источников электрического поля. 3.3. Отклоняющие и компенсационные магнитные экраны.	2
10.50-11.20	Перерыв/Кофе-брейк	
11.20-12.50	3.4. Выбор формы и типа низкочастотного экрана. 3.5. Методы повышения эффективности экрана. 3.6. Перфорированные магнитные экраны. 3.7. Примеры из практики.	2
12.50-13.50	Обед	
13.50-15.20	4. Токопроводящие прокладки для экранирующих корпусов: 4.1. Правила выбора и применения. 4.2. Требования к корпусным деталям, соединяемым при помощи прокладок.	2
15.20-15.50	Перерыв/Кофе-брейк	
15.50-17.20	5. Пластиковые и композитные экранирующие корпуса: 5.1. Преимущества и недостатки токопроводящих покрытий. 5.2. Сравнение технологий нанесения токопроводящих покрытий. 5.3. Требования к корпусным деталям при использовании таких покрытий.	2
ИТОГО		16